Паспорт сервера

YasnoCore H200-4

Документ YCH2004 ПС 01 • Редакция 1.0 • 18.11.2026

4 × NVIDIA H200 NVL 141 ГБ • 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ RAM • 4U



Базовая платформа ASRock Rack 4U8G-GENOA2. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.

Параметр	Сведения модели
Изготовитель	ООО «ЯСНОКОР», ИНН 2100033229, ОГРН 1262100003175
Базовая платформа	ASRock Rack 4U8G-GENOA2; системная плата GENOA2D24G-2L+
Идентификация RAM	YCH2004-512-R0; YCH2004-1024-R0; YCH2004-2048-R0
Декларация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.83522/26 от 18.11.2026; срок до 17.11.2031
Связь с изготовителем	info@yasnocore.ru • +7 927 841-00-61 • cbr.yasnocore.ru

Паспорт описывает модель, варианты комплектования и порядок эксплуатации. Серийный номер, фактические артикулы, версии и записи контроля оформляются в разделе индивидуальных сведений экземпляра.

1 Назначение и конструкция

Сервер предназначен для обработки и хранения данных, вычислений и задач искусственного интеллекта в профессиональной ИТ-инфраструктуре. Эксплуатация предусмотрена в серверных помещениях и ЦОД обученным персоналом.

Ниже приведены характеристики базовой платформы из оригинальных руководств ASRock Rack. Их предельные возможности отделены от состава выбранного исполнения YasnoCore. Привязки M1 и B1 указывают печатные страницы руководств и физические страницы PDF; ссылки находятся в конце паспорта.

Сведения ASRock Rack	Источник
Стоечный корпус 4U; габариты 786 × 438 × 176,5 мм.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Базовая серверная плата GENOA2D24G-2L+.	M1 стр. 1, 3 (PDF 6, 8)
Два процессорных разъёма SP5 (LGA 6096); AMD EPYC 9004, 9004 с 3D V-Cache, 97x4 и 9005; для 9005 требуется обновление BIOS.	M1 стр. 4 (PDF 9)
В спецификации платформы указан TDP процессоров до 400 Вт.	M1 стр. 4 (PDF 9)
Архитектура System on Chip.	M1 стр. 4 (PDF 9)

Процессоры выбранного исполнения

Состав YasnoCore	Характеристики
2 × AMD EPYC 9354	На один CPU: 32 ядра, 64 потока; базовая частота 3,25 ГГц; номинальный TDP 280 Вт; SP5. Всего 64 ядра и 128 потоков.
Память CPU	DDR5 до 4800 MT/s. Рабочая скорость определяется процессором, модулями и настройкой BIOS.
Масса изделия	Указывается для фактической комплектации; в использованном руководстве платформы значение не приведено.

Источник параметров CPU: AMD EPYC 9354 [A1]. Частоты, температура и потребление под нагрузкой фиксируются для экземпляра; TDP не является измерением потребления всего сервера.

2 Оперативная память

Код исполнения	Объём RAM	Комплект DIMM
YCH2004-512-R0	512 ГБ	16 × 32 ГБ ECC DDR5 RDIMM
YCH2004-1024-R0	1024 ГБ	16 × 64 ГБ ECC DDR5 RDIMM
YCH2004-2048-R0	2048 ГБ	16 × 128 ГБ ECC DDR5 RDIMM

Сведения ASRock Rack	Источник
24 слота DIMM: 12 на CPU0 и 12 на CPU1, один DIMM на канал (1DPC).	M1 стр. 4, 38 (PDF 9, 43)
DDR5 288-pin RDIMM и RDIMM-3DS; напряжение 1,1 В.	M1 стр. 4 (PDF 9)
На один модуль: RDIMM до 128 ГБ (2Rx4), RDIMM-3DS до 256 ГБ (2Rx4).	M1 стр. 4 (PDF 9)
В таблице спецификации GENOA2D24G-2L+ указана скорость до 4800 МГц; схема платы подписана 4800 MT/s.	M1 стр. 4, 38 (PDF 9, 43)
Устанавливать DIMM только в совпадающей с ключом ориентации; применение силы при неверной ориентации повреждает модуль и плату.	M1 стр. 44 (PDF 49)
Рекомендация OEM для 16 DIMM и двух CPU: CPU0 — A1, B1, C1, E1, G1, H1, I1, K1; CPU1 — M1, N1, O1, Q1, S1, T1, U1, W1.	B1 стр. 21, 22 (PDF 28, 29)
OEM требует одинаковые DDR5 DIMM по изготовителю, скорости, объёму и типу микросхем в соответствующей конфигурации.	B1 стр. 21 (PDF 28)

Карта установки относится к GENOA2D24G-2L+ при двух CPU. Перед сборкой сверяют маркировку платы и её ревизию с руководством B1. Артикулы DIMM выбираются по Memory QVL; сочетание модулей и рабочая скорость фиксируются в паспорте экземпляра.

При установке 16 модулей используются восемь каналов памяти каждого CPU. Номинальная ёмкость RAM и физическая память GPU HBM относятся к разным подсистемам.

3 Накопители и расширение

Сведения ASRock Rack	Источник
Спереди 24 отсека 2,5 дюйма с горячей заменой: 4 NVMe PCIe 5.0 x4 и 20 SATA/SAS.	M1 стр. 3, 6, 9 (PDF 8, 11, 14)
Пассивная 24-портовая панель NVMe/SATA/SAS; для 20 SATA/SAS отсеков требуется дополнительный RAID/HBA, в том числе для SAS.	M1 стр. 3, 6, 9 (PDF 8, 11, 14)
Два внутренних M-key M.2: по одному от CPU0 и CPU1; 2280/22110, PCIe 3.0 x4 либо SATA 6 Гбит/с.	M1 стр. 3, 38 (PDF 8, 43)
Сзади восемь полноразмерных двухслотовых позиций FHFL PCIe 5.0 x16; в спецификации указана прямая связь с CPU.	M1 стр. 4, 10 (PDF 9, 15)
Спереди один FHHL PCIe 5.0 x8.	M1 стр. 4, 9 (PDF 9, 14)
Спереди предусмотрена отдельная резервируемая монтажная позиция для платы FHHL.	M1 стр. 6, 8, 9 (PDF 11, 13, 14)
Один разъём OCP NIC 3.0 с интерфейсом PCIe 5.0 x8.	M1 стр. 4, 9 (PDF 9, 14)

Накопители выбранного исполнения

В составе предусмотрены 2 × Samsung PM9A3 NVMe по 3,84 ТБ и контроллер Broadcom MegaRAID 9560-16i Tri-Mode. Заказной P/N SSD, ревизия backplane, кабели, порты и созданный массив фиксируются в схеме сборки.

Способ подключения NVMe к платформе или через MegaRAID определяется реальной кабельной схемой. Наличие Tri-Mode и перечисление поддерживаемых RAID-уровней не подтверждают созданный аппаратный массив. RAID 5/6/10 требуют соответствующего числа носителей; для двух SSD проверяется согласованный способ резервирования.

OCP является специализированным посадочным местом. GPU, Ethernet, FC, RAID и резервная позиция средства защиты размещаются по единой карте слотов с учётом общих пространств и доступных линий.

4 Панели и внешние интерфейсы



Фронтальная панель базовой платформы. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.



Задняя панель базовой платформы. Оригинальная фотография базовой платформы ASRock Rack; комплектация изображения справочная.

Сведения ASRock Rack	Источник
Два логических интерфейса 1GbE на Intel i350. RJ45 спереди и сзади являются общими выводами этих интерфейсов.	M1 стр. 3, 4, 5, 11, 12 (PDF 8, 9, 10, 16, 17)
Спереди четыре USB Type-A 3.2 Gen1; сзади два USB Type-A 3.2 Gen1.	M1 стр. 3, 5, 11, 12 (PDF 8, 10, 16, 17)
Передний и задний разъёмы DB15 VGA.	M1 стр. 3, 5, 11, 12 (PDF 8, 10, 16, 17)
Кнопки питания, Reset, NMI и UID; индикаторы питания, UID, дисковой активности и системной неисправности.	M1 стр. 11, 12, 13 (PDF 16, 17, 18)
Кнопка Power переводит между включением и standby; для полного обесточивания требуется отсоединить все кабели электропитания.	M1 стр. 13, 18 (PDF 18, 23)
UID служит для поиска сервера в стойке, переключая передний и задний индикаторы идентификации.	M1 стр. 13 (PDF 18)
Reset предназначен для принудительного перезапуска зависшего сервера; NMI формирует немаскируемое прерывание для диагностики.	M1 стр. 13 (PDF 18)

Передние и задние штатные LAN-разъёмы используют общие интерфейсы. Точки подключения выделенного IPMI LAN также разделяемые. Число видимых разъёмов не суммируется как число независимых сетевых адаптеров. Дополнительные X710-DA2 и FC HBA перечислены отдельно.

5 Управление и программное обеспечение

Сведения ASRock Rack	Источник
Один выделенный интерфейс управления на Realtek RTL8211F; передний и задний выводы IPMI общие.	M1 стр. 3, 4, 5, 11, 12 (PDF 8, 9, 10, 16, 17)
BMC ASPEED AST2600; графический контроллер AST2600, видеопамять DDR4 512 МБ.	M1 стр. 4 (PDF 9)
AMI UEFI BIOS; SPI Flash 256 Мбит (32 МБ); ASRock Rack Instant Flash, ACPI 6.4 и выше, SMBIOS 3.5.0 и выше, PnP.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Контроль температур CPU, платы и области карт; тахометры вентиляторов и многоступенчатое регулирование скорости; контроль основных напряжений.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Плата имеет 13-контактный SPI TPM header. Наличие разъёма не устанавливает наличие самого модуля или сертификатов СЗИ.	B1 стр. 3 (PDF 10)
Руководство BIOS описывает Secure Boot и управление ключами; исходная настройка Secure Boot Disabled. Фактическое состояние фиксируют в паспорте экземпляра.	B1 стр. 93, 94, 95 (PDF 100, 101, 102)
Для EPYC 9004 в OEM-списке указаны Windows Server 2019/2022; RHEL 8.6/8.7/9.0/9.1, SLES 15.4, Ubuntu 20.04.5/22.04/22.10; ESXi 7.0 U3i/8.0 и Citrix Hypervisor 8.2.1. Это список платы, не квалификация H200, российских ОС или поставляемых лицензий.	B1 стр. 4 (PDF 11)

Программный профиль YasnoCore

Компонент	Правило комплектования
Операционная система	Linux семейства Debian либо RHEL. Дистрибутив, версия, подписка и лицензии определяются спецификацией поставки.
GPU-программный стек	Совместимые NVIDIA Driver, CUDA Toolkit и cuDNN. Версии и параметры сохраняются с редакцией комплектации.
Управление	IPMI/KVM и доступные функции BMC. Состав Virtual Media и лицензий проверяется в поставляемом firmware.
Средства защиты	Совместимость с требуемыми СЗИ подтверждается отдельно для точных BIOS, платы, ОС и версий СЗИ. Наличие разъёма или функции BIOS не подтверждает поставку защитного модуля и лицензий.

Управляющий интерфейс размещают в выделенной сети с ограничением доступа. Учётные данные меняют при вводе в эксплуатацию; секреты и ключи в публичный паспорт не включаются. Обновления BIOS/BMC выполняют по инструкции соответствующей модели с резервной копией конфигурации и согласованным окном работ.

6 Состав исполнения YasnoCore

Количество указано на один сервер. Окончательный комплект поставки определяется подписанной спецификацией, а фактические P/N и S/N — индивидуальными сведениями экземпляра.

Узел	Модель и состав	Количество
Платформа	4U8G-GENOA2	1
CPU	AMD EPYC 9354	2
RAM	ECC DDR5 RDIMM; 512/1024/2048 ГБ	16 модулей
GPU	NVIDIA H200 NVL 141 ГБ PCIe	4
NVLink	Комплект 4-way для четырёх H200 NVL	1 группа
SSD	Samsung PM9A3 NVMe 3,84 ТБ	2
RAID	Broadcom MegaRAID 9560-16i Tri-Mode	1
Ethernet	Intel X710-DA2, 2 × 10GbE SFP+	2
Оптика Ethernet	SFP+ SR 10G LC/MMF	4
Fibre Channel	Emulex LPe31002-M6, 2 × 16G FC	1
Оптика FC	16G FC SW LC/MMF	2
Блоки питания	CRPS 1600 Вт при 200–240 В	4
Монтаж	Направляющие, кабельный организатор и силовой комплект	По спецификации
Резерв СЗИ	Совместимая свободная позиция для согласованного модуля защиты	По карте слотов

Физическое число деталей в комплекте NVLink, межслотовый шаг и силовые кабели задаются по точным артикулам выбранных GPU и OEM-комплекта. Резерв позиции для СЗИ не означает включение самого модуля и его лицензий.

7 Графические ускорители и NVLink

Параметр	Исполнение модели
Ускорители	4 × NVIDIA H200 NVL PCIe; по 141 ГБ HBM3e
Суммарная физическая HBM	564 ГБ; сумма памяти карт, не отдельная общая область памяти
Соединение	1 группа из четырёх GPU с 4-way NVLink
Параметры одной H200 NVL	PCIe Gen5, двухслотовое воздушное исполнение; пропускная способность HBM 4,8 ТБ/с; TDP до 600 Вт [N1].
Установка	Точные OEM-позиции, P/N GPU, мостов и силового комплекта, шаг и CPU-домены фиксируются в карте сборки.

Логическая группировка

Группа NVLink 1	GPU в группе
Комплект 4-way 1	1, 2, 3, 4

Физическое число слотов платформы и официальный анонс поддержки H200 NVL учитываются вместе с точной спецификацией. OEM-публикация от 18.03.2024 называет обе GENOA2; запись NVIDIA QSC и адресное подтверждение полной комплектации имеют отдельную область проверки [P2].

Контроль после установки

- Сверить карту слотов с фактической маркировкой, PCIe BDF и CPU-доменами.
- Убедиться в обнаружении всех GPU и соединений NVLink; сохранить вывод nvidia-smi -L и nvidia-smi topo -m.
- Проверить ошибки PCIe/ECC/Xid, температуры, частоты и ограничения мощности при согласованной нагрузке.
- Проверить обмен между картами по утверждённой методике; сохранить версии ПО, команды и журналы.

8 Питание охлаждение и условия среды

Сведения ASRock Rack	Источник
Четыре сменных CRPS, штатная схема 3+1, класс эффективности 80 PLUS Platinum.	M1 стр. 3, 25 (PDF 8, 30)
Мощность одного штатного БП до 1600 Вт при входном напряжении 200–240 В AC.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Мощность одного штатного БП до 1000 Вт при входном напряжении 100–127 В AC.	M1 стр. 3 (PDF 8)
В спецификации для low-line/high-line указаны частоты 47/63 Гц.	M1 стр. 3 (PDF 8)
Для полной нагрузки OEM предусматривает три работающих БП; четвёртый — резервный с разделением нагрузки. В исправной резервируемой системе допускается извлечение одного БП.	M1 стр. 25 (PDF 30)
Для 200–240 В арифметическая суммарная выходная мощность 4 × 1600 = 6400 Вт; при 3+1 — 3 × 1600 = 4800 Вт.	M1 стр. 3, 25 (PDF 8, 30)
Пять средних вентиляторов 80 × 80 мм с горячей заменой; в руководстве указано направление стрелки вентилятора к задней части корпуса.	M1 стр. 3, 27 (PDF 8, 32)
Эксплуатировать систему с установленными верхними крышками; перед снятием крышек выключить сервер и отсоединить кабели питания.	M1 стр. 19 (PDF 24)
OEM рекомендует свободное пространство перед стойкой 25 дюймов, позади 30 дюймов для доступа и вентиляции (приблизительно 635 и 762 мм).	M1 стр. без номера (PDF 3)
Диапазон рабочей температуры платформы: +10…+35 °C.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Температура в нерабочем состоянии: −40…+70 °C.	M1 стр. 5 (PDF 10)
Относительная влажность в нерабочем состоянии: 20–90 %, без конденсации.	M1 стр. 5 (PDF 10)

Номинальный расчёт при 200–240 В

Расчётная величина	Значение
Сумма установленной мощности БП	4 × 1600 = 6400 Вт DC
Ёмкость при схеме 3+1	3 × 1600 = 4800 Вт DC
Номиналы GPU и CPU	4 × 600 + 2 × 280 = 2960 Вт
Остаток до учёта остальных узлов	4800 − 2960 = 1840 Вт

Расчёт не включает RAM, вентиляторы, SSD, платы и коммутацию; потребление AC измеряется отдельно. Наличие четырёх БП и схема 3+1 сами по себе не подтверждают резервирование двух вводов A/B. Распределение по PDU/ИБП проверяется для полной нагрузки и отказа заданного ввода.

9 Монтаж и ввод в эксплуатацию

Сведения ASRock Rack	Источник
Комплект направляющих включает наружную, среднюю и внутреннюю части; соблюдать маркировку L/R, фиксировать корпус винтами и проверять фиксацию шарикового держателя.	M1 стр. 45, 46, 47 (PDF 50, 51, 52)
OEM-комплект: barebone с восемью 12V-2x6 кабелями, два радиатора CPU, комплект рельсов; аксессуары — восемь CPU 8-pin, восемь PCIe 8-pin, четыре сетевых кабеля, QIG, два винта M.2.	M1 стр. 2 (PDF 7)
Карта GPU вставляется в предназначенную позицию и фиксируется винтом; подключение через установленный на switch board кабель 12V-2x6 либо подходящий 8-pin из комплекта по типу карты; разъём должен полностью защёлкнуться.	M1 стр. 30, 31 (PDF 35, 36)
Лотки извлекаются после разблокировки рычага; накопитель крепится штатными фиксирующими штифтами; лоток задвигается до полного сопряжения и закрывается рычагом.	M1 стр. 23, 24 (PDF 28, 29)
Перед установкой CPU полностью отключить питание; процессор устанавливается вместе с carrier frame. Для радиатора руководство указывает последовательность затяжки 1→2→3→4→5→6, ослабление в обратном порядке, момент 10,8–13,0 in-lb.	M1 стр. 39, 41, 43 (PDF 44, 46, 48)

Последовательность ввода

1. Сверить изделие и упаковку со спецификацией; записать S/N, P/N, ревизии и повреждения, если они есть.
2. Подготовить стойку, направляющие, заземление, вводы питания, вентиляцию и сеть управления. Исключить одновременное выдвижение нескольких тяжёлых устройств из стойки.
3. Проверить установку CPU, DIMM, карт, мостов, носителей и воздуховодов по схеме сборки. Внутренние работы проводит подготовленный персонал.
4. Подключить согласованные силовые и сетевые кабели; задать доступ к BMC и сохранить исходную конфигурацию.
5. При первом включении проверить POST и перечень CPU/RAM/SSD/PCIe; записать BIOS/BMC и параметры памяти.
6. Установить согласованную ОС и GPU-стек, затем выполнить функциональные и нагрузочные проверки. Сохранить журналы и замечания.
7. Оформить паспорт экземпляра, комплектность, результат приёмки и сервисные условия. Передать документацию и резервные копии конфигураций заказчику.

10 Индикация диагностика и обслуживание

Сведения ASRock Rack	Источник
UID: синий — идентификация активна; Power: зелёный — система включена; System Fault: красный — как минимум один датчик сообщает критическое состояние.	M1 стр. 13 (PDF 18)
Индикатор дисковой активности на панели мигает зелёным при обращениях.	M1 стр. 13 (PDF 18)
Лоток накопителя: синий Power — питание подано; зелёный Activity — активен; мигание зелёным — обращение; красный — отказ.	M1 стр. 17 (PDF 22)
БП: зелёный — исправен и выход включён; мигающий зелёный 0,5 Гц — присутствует AC, только 12VSB или Smart Redundant; янтарный — авария/защита либо отключён кабель; мигающий янтарный 0,5 Гц — предупреждение.	M1 стр. 16 (PDF 21)
Активность LAN отображается мигающим жёлтым, наличие соединения — постоянным индикатором. Цвет индикатора скорости сверять по конкретной передней/задней панели.	M1 стр. 14, 15 (PDF 19, 20)

Действия при отклонениях

Признак	Проверка и действие
Системный Fault или перегрев	Сохранить события BMC/SEL и показания датчиков. Проверить потоки воздуха, вентиляторы, крышки и условия помещения; согласовать снижение или остановку нагрузки.
GPU не обнаружена или нет NVLink	Проверить журнал ОС, PCIe, драйвер и карту соединений. Внутренние подключения проверяют после штатного отключения всех вводов питания.
Событие накопителя или RAID	Сохранить состояние контроллера/SSD, определить проблемный носитель по идентификатору. Замена и восстановление выполняются по согласованной процедуре с резервной копией.
Предупреждение БП	Проверить все AC-вводы, PDU/ИБП и код индикации. Горячая замена допускается только при достаточной оставшейся мощности и по процедуре OEM.

Периодичность профилактики устанавливается регламентом площадки с учётом запылённости и нагрузки. Записи о чистке, замене узлов и обновлениях вносятся в журнал. Сжатый воздух, инструменты и расходные материалы применяют только по одобренной сервисной процедуре.

11 Безопасность хранение и сопровождение

Сведения ASRock Rack	Источник
Монтаж, разборку и обслуживание выполняет подготовленный персонал; питание подключается к розетке с защитным заземлением; при полном обесточивании отсоединяются все источники.	M1 стр. без номера, без номера, 18 (PDF 3, 4, 23)
Компоненты держат за края, используют заземлённую антистатическую защиту, не касаются контактов и сохраняют извлечённые платы в антистатической упаковке.	M1 стр. без номера, 18 (PDF 4, 23)
Батарею заменяют только на надлежащий тип и утилизируют согласно инструкции производителя.	M1 стр. без номера (PDF 4)

Перемещение и хранение

Используют подходящую упаковку и защиту от ударов, пыли, влаги и электростатического разряда. Модули и кабели закрепляют по транспортной инструкции. Перемещение укомплектованного сервера выполняют с подходящими средствами и числом подготовленных работников.

По OEM: нерабочая температура −40…+70 °C; нерабочая влажность 20–90% без конденсации [M1, стр. 5]. Эти значения не являются диапазоном рабочей влажности. После перемещения из холодной среды включение допускается после выравнивания температуры и полного исчезновения конденсации.

Гарантия и техническая поддержка

Срок гарантии, дата её начала, сервисный документ, перечень услуг и SLA указываются в договоре и индивидуальном разделе паспорта. Расширенная поддержка оформляется отдельным сертификатом или приложением к поставке. Настоящий паспорт не задаёт новый срок гарантии вместо согласованных условий.

Обращение направляется изготовителю с моделью, S/N, описанием проявления, временем и безопасно подготовленными диагностическими материалами. Способ передачи журналов согласуется отдельно. Носители с данными и удалённый доступ обрабатываются по договору и правилам заказчика.

Изготовитель и контакты

Сведения	Контакт
Изготовитель	ООО «ЯСНОКОР», ИНН 2100033229, КПП 210001001, ОГРН 1262100003175
Юридический адрес	428003, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 7, к. 1, кв. 144
Площадка сборки	428003, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 1, помещения 19 и 20
Техническая связь	info@yasnocore.ru; +7 927 841-00-61; https://cbr.yasnocore.ru/

12 Сведения о конкретном экземпляре

Раздел заполняется при изготовлении и передаче сервера. Подтверждённые записи относятся только к указанному экземпляру и редакции его комплектации. Поля остаются пустыми до внесения фактических данных.

Идентификатор	Данные экземпляра
Модель	YasnoCore H200-4
Код исполнения и редакция комплектации	_____
Серийный номер и дата изготовления	_____
Платформа и ревизия платы	_____
P/N и S/N CPU и DIMM	По приложенной ведомости № _____
P/N и S/N GPU и мостов	По приложенной ведомости № _____
P/N и S/N SSD и контроллера	_____
Карта PCIe и схема NVMe/RAID	Документы № _____
Модели БП и силового комплекта	_____
BIOS и BMC	_____
ОС ядро драйвер NVIDIA CUDA cuDNN	_____
Договор и комплектность	_____
Документ гарантии и срок	_____
Протокол и первичные журналы	_____
Контролёр дата и подпись	_____
Решение о приёмке и замечания	_____

Функциональные и нагрузочные результаты записывают в протоколе с серийным номером, условиями, методикой и версиями ПО. Расчётные показатели и документация платформы не заполняют фактические результаты контроля.

13 Соответствие источники и учёт изменений

На модели H200-4 и H200-8 зарегистрирована декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.83522/26 от 18.11.2026, срок действия до 17.11.2031, схема 1д, серийный выпуск. Регламенты: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Статус в выгрузке ФСА от 18.11.2026: «Действует».

Декларация PDF • Запись в реестре ФСА

Технические источники

M1 ASRock Rack 4U8G-GENOA2 User Manual v1.03, январь 2026. Характеристики: стр. 3–5; обзор и панели: 6–12; индикация: 13–17; установка и обслуживание: 18–33; плата: 34–44; монтаж в стойку: 45–47.
Открыть источник M1

Q1 ASRock Rack 4U8G-GENOA2 Quick Installation Guide v1.0. Обзор соединений и монтажа.
Открыть источник Q1

B1 ASRock Rack GENOA2D24G-2L+ User Manual v3.30, октябрь 2026. Карта 16 DIMM: печатная стр. 22, PDF 29. Применять разделы своей модели платы.
Открыть источник B1

P1 Официальная карточка базовой платформы ASRock Rack; ключевые характеристики проверены 18.11.2026. Полная таблица Specifications сохранена 17.11.2026.
Открыть источник P1

P2 Официальное заявление ASRock Rack о поддержке H200 NVL, 18.03.2024. Абзац после описания NVIDIA MGX, где перечислены обе GENOA2.
Открыть источник P2

N1 NVIDIA H200, публичная таблица спецификаций H200 NVL. Характеристики GPU и группировка NVLink.
Открыть источник N1

A1 AMD EPYC 9354, официальные характеристики процессора.
Открыть источник A1

Журнал обслуживания и изменений

Дата	Работа или изменение	Документ и исполнитель
_____	_____	_____
_____	_____	_____